

集成电路用抛光液国内龙头

投资要点

- **公司营收再创新高,研发投入持续增长。**公司 2018 年度实现营业收入 2.5 亿元,较上年增长 6.6%,归母净利润 0.5 亿元,较上年增长 13.1%,营收和利润持续稳定增加。铜及铜阻挡层系列是公司收入的最主要来源,2018 年销售收入 1.6 亿元,占总营收的 66.3%。2018 年公司研发费用为 5363.1 万元,占营业收入的比例为 21.6%,近年来研发投入不断加大,高研发打造企业核心竞争力。
- **抛光液市场前景广阔,公司增长空间大。**2019 年半导体材料市场将达到 500 亿美元之上,增长超过 3%。由于各种半导体芯片的需求稳步增长,使 2018 年的材料市场总收入达到 489 亿美元,而预计到 2023 年的复合年增长率 (CAGR) 预计为 4.3%。2018 年全球 CMP 抛光材料市场规模为 20.1 亿美元,其中抛光液和抛光垫市场规模分别为 12.7 亿美元和 7.4 亿美元,预计 2017-2020 年全球 CMP 抛光材料市场规模年复合增长率为 6%。
- **国外公司长期垄断,国产替代急需推进。**由于科技含量极高,CMP 抛光材料研发所需的资金投入较大,一些较小的供应商,无法承受巨大的研发投入。与此同时美国和日本等国际巨头利用先发优势在研发和生产方面不断革新,同时实行严格的专利保护封锁技术防止外泄,构筑难以突破的技术壁垒。
- **国产抛光液龙头企业,产品技术节点不断向下突破。**公司核心技术产品涵盖化学机械抛光液和光刻胶去除剂两大类,核心技术的应用主要体现在产品配方和生产工艺流程两个方面。公司化学机械抛光液包括铜及铜阻挡层系列、其他系列等系列产品。
- **技术能力强劲,先进制程节点产品进展顺利。**铜及铜阻挡层系列主要应用于制造先进的逻辑芯片和先进的存储芯片,目前公司铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液技术节点涵盖 130-28nm 芯片制程,已实现规模化销售,主要应用于国内 8 英寸和 12 英寸主流晶圆产线,可以满足国内芯片制造商的需求,并已在海外市场实现突破。此外,14nm 技术节点产品已进入客户认证阶段,10-7nm 技术节点产品正在研发中。公司产品光刻胶去除剂是用于图形化工艺光刻胶残留物去除的高端湿化学品,其核心技术包括光阻清洗中金属防腐蚀技术、光刻胶残留物去除技术。
- **竞争能力领先,国产替代加速。**截至 2018 年 12 月 31 日,公司拥有授权发明专利 190 项,覆盖中国大陆、中国台湾、美国、新加坡、韩国等多个国家和地区。公司已成为中芯国际、长江存储等中国大陆领先芯片制造商的主流供应商,并成为台湾地区台积电、联电等全球领先芯片制造商的合格供应商。2018 年度公司化学机械抛光液全球市场占有率 2.4%,成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,实现了进口替代,使中国在该领域拥有了自主供应能力。
- **风险提示:** 客户集中度较高、产品结构单一的风险;原材料供应及价格上涨风险;产品研发或不及预期;半导体行业景气度下行风险。

西南证券研究发展中心

分析师: 刘言
执业证号: S1250515070002
电话: 023-67791663
邮箱: liuyan@swsc.com.cn
联系人: 陈杭
电话: 021-68415309
邮箱: chenhang@swsc.com.cn

本次发行情况

发行前总股本(万股)	3983
本次发行(万股)	1327
发行后总股本(万股)	5310
2018 年每股收益(摊薄后)(元)	1.13
2018 年扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄后)(元)	1.08

主要指标 (2018)

每股净资产(元)	8.71
毛利率(%)	51.10
流动比率	5.06
速动比率	2.88
应收账款周转率	4.82
资产负债率(%)	19.98
净资产收益率(%)	13.30

相关研究

目 录

1 深耕优势领域，稳步发展焕新颜	1
1.1 重组股权架构，筹备拥抱崭新未来	1
1.2 优化核心结构，护航产品技术领先优势	1
1.3 “抛光去除”，聚焦发力核心产品	3
2 财务报表健康，各项指标稳健	3
2.1 营收持续增长、毛利率稳健强劲	3
2.2 研发持续高投入，未来发展可期	5
3 国产替代正当时，CMP 需求将维持高增长	6
4 美日厂商垄断 CMP 市场，奋起直追正当时	8
5 风险提示	9

图 目 录

图 1: 公司发展历程.....	1
图 2: 公司股权架构图.....	2
图 3: 公司地区布局.....	2
图 4: 公司人员结构.....	2
图 5: 公司产品介绍.....	3
图 6: 公司工艺结构流程图.....	3
图 7: 2016-2018 年营收及增长率.....	4
图 8: 2016-2018 年归母净利润及增长率.....	4
图 9: 2016-2018 年公司 ROE 与每股收益.....	4
图 10: 2016-2018 年公司净资产和净利润走势.....	4
图 11: 2016-2018 年公司毛利率.....	5
图 12: 2018 年公司产品毛利构成.....	5
图 13: 2016-2018 年公司各项费用.....	5
图 14: 2018 年公司费用收入占比.....	5
图 15: 2016-2018 年公司研发费用及增长率.....	6
图 16: 2016-2018 年公司研发费用构成.....	6
图 17: 晶圆制造材料投资占比.....	7
图 18: CMP 各细分材料份额占比.....	7
图 19: CMP 发展历程.....	7
图 20: CMP 工艺原理图.....	7
图 21: 全球半导体材料市场空间.....	8
图 22: 全球 CMP 材料市场空间.....	8
图 23: 全球 CMP 抛光垫市场竞争格局.....	8
图 24: Cabot Microelectronics 全球抛光液市场份额变化.....	8

表 目 录

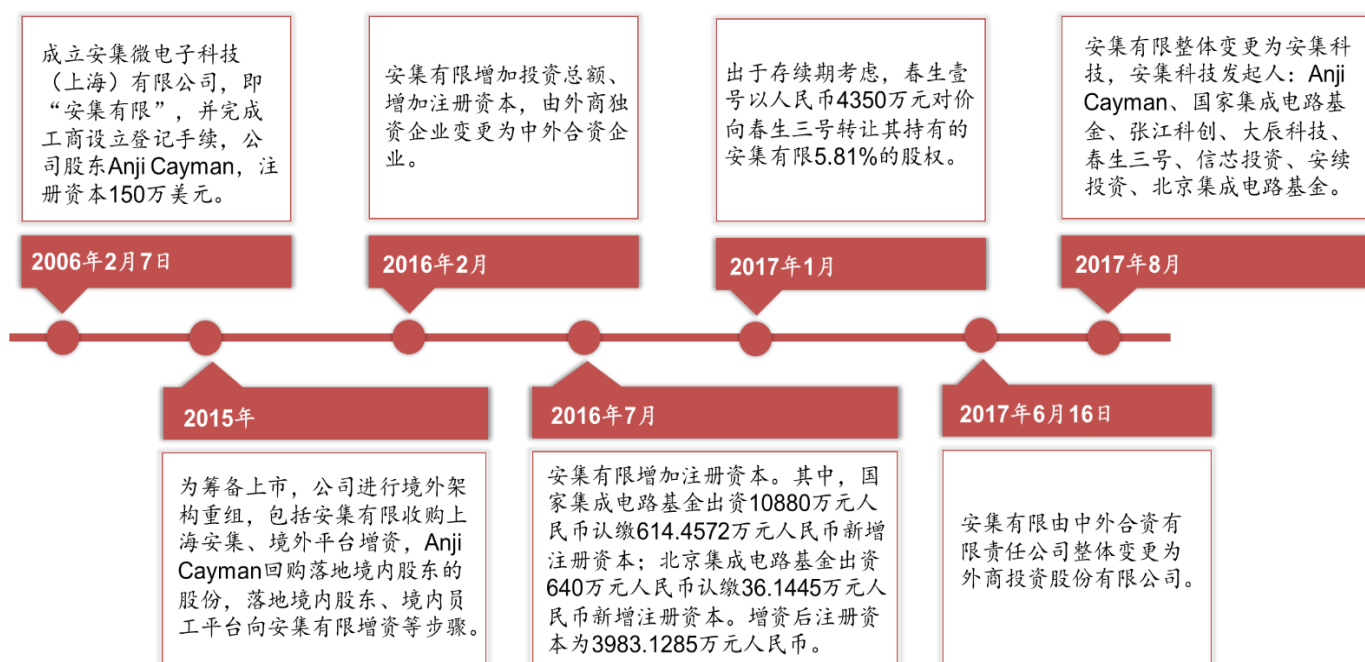
表 1: 公司抛光液产品主要竞争对手.....	9
-------------------------	---

1 深耕优势领域，稳步发展焕新颜

1.1 重组股权架构，筹备拥抱崭新未来

安集微电子是经由安集有限整体变更设立的股份有限公司，安集有限成立于 2006 年 2 月 7 日。公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域有了自主供应能力。

图 1：公司发展历程



数据来源：招股说明书，西南证券整理

1.2 优化核心结构，护航产品技术领先优势

公司控股股东为 Anji Cayman，占股 56.6%。Anji Cayman 为一家投资控股型公司，不实际从事生产经营业务，其股东包括：RUYI、北极光、Yuding、东方华尔、CRS、SMS、SGB、Anjoin。

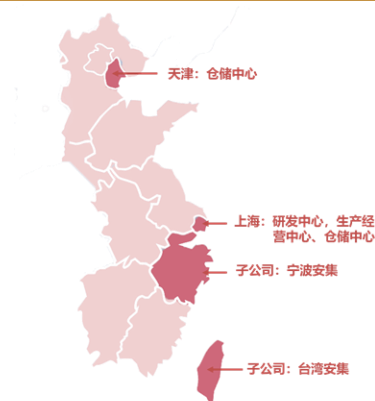
图 2：公司股权架构图



数据来源：招股说明书，西南证券整理

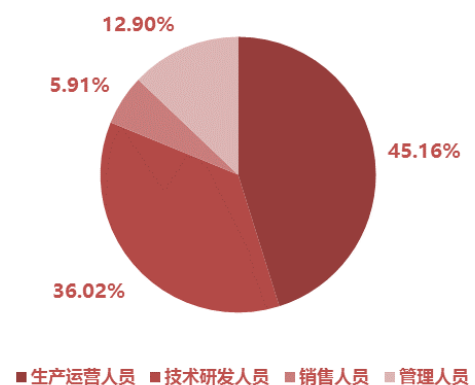
目前，公司共有 3 家全资子公司，分别为上海安集（2004 年成立）、宁波安集（2017 年成立）、台湾安集（2015 年成立），无参股子公司。上海为公司总部、研发中心、生产经营中心、仓储中心，天津设有仓储中心。此外，台湾安集主要承担公司市场开发、研发支持以及中国台湾及新加坡等国家或地区客户维护职能。截至 2018 年 12 月 31 日，公司员工 186 人，其中生产运营和技术研发人员占绝对比例。

图 3：公司地区布局



数据来源：招股说明书，西南证券整理

图 4：公司人员结构



数据来源：西南证券整理

1.3 “抛光去除”，聚焦发力核心产品

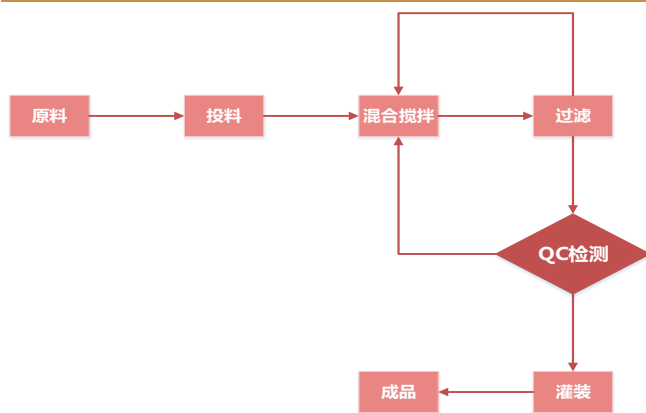
核心技术产品涵盖化学机械抛光液和光刻胶去除剂两大类，公司化学机械抛光液包括铜及铜阻挡层系列、其他系列等系列产品。铜及铜阻挡层系列主要应用于制造先进的逻辑芯片和先进的存储芯片，目前公司铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液技术节点涵盖 130-28nm 芯片制程，已实现规模化销售，主要应用于国内 8 英寸和 12 英寸主流晶圆产线，可以满足国内芯片制造商的需求，并已在海外市场实现突破。此外，14nm 技术节点产品已进入客户认证阶段，10-7nm 技术节点产品正在研发中。公司其他系列化学机械抛光液包括钨抛光液、硅抛光液、氧化物抛光液等产品，已供应国内外多家芯片制造商，具体生产规模会根据客户需求量进行调节。

图 5：公司产品介绍



数据来源：招股说明书, 西南证券整理

图 6：公司工艺结构流程图



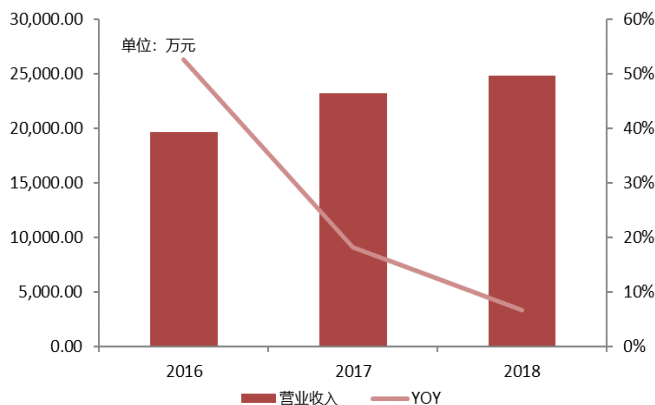
数据来源：西南证券整理

2 财务报表健康，各项指标稳健

2.1 营收持续增长、毛利率稳健强劲

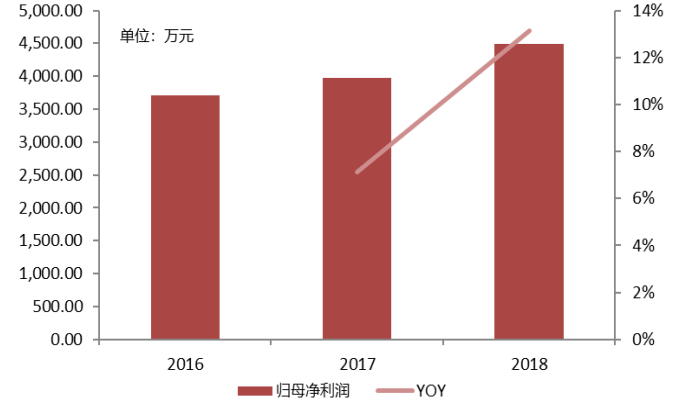
公司 2018 年度实现营业收入 2.5 亿元，较上年增长 6.6%，归母净利润 0.5 亿元，较上年增长 13.1%，营收和利润持续稳定增长。2016、2017 和 2018 年公司营业收入增长率分别为 52.7%、18.2%和 6.6%，增长率下降明显，原因是期初公司销售规模易实现大幅增长，公司为持续发展选择在产品开发、客户开拓及资源配置等方面有所侧重，产品研发验证门槛高、周期长，因此现阶段通过更多客户、更多产品线实现线性增长受到制约。2018 年净利润增长率显著上升，主要是因为公司形成了有利于企业持续经营的商业模式，依靠核心技术形成较强成长性，技术成果有效转化为经营成果。

图 7: 2016-2018 年营收及增长率



数据来源: 公司公告, 西南证券整理

图 8: 2016-2018 年归母净利润及增长率

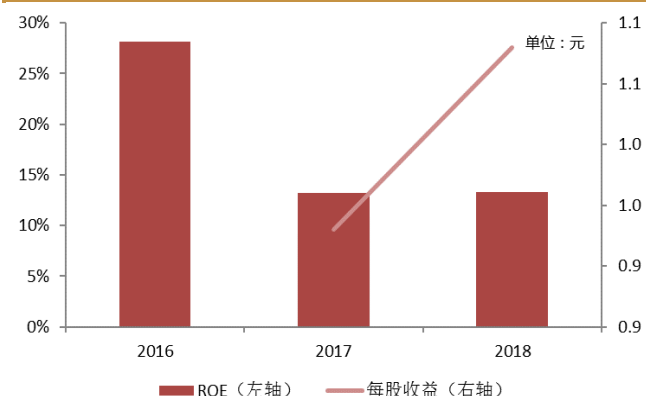


数据来源: 公司公告, 西南证券整理

铜及铜阻挡层系列是公司收入的最主要来源, 2018 年销售收入 1.6 亿元, 占总营收的 66.3%。公司的产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂, 其中抛光液包括铜及铜阻挡层系列和其他系列, 光刻胶去除剂包括集成电路制造用、晶圆级封装用和 LED/OLED 用。公司在 130-28nm 技术节点实现规模化销售, 14nm 技术节点产品已进入客户认证阶段, 10-7nm 技术节点产品正在研发中。据 Gartner 测算, 2018 年 28nm 以上工艺产能仍占全球总产能的 90%, 国内除中芯国际 28nm 扩产、14nm 工艺验证和台积电南京厂 16nm 工艺扩产外, 多数新增产能主要集中在 65nm-90nm 的特色工艺和模拟工艺。从集成电路制程技术发展历程和公司过往销售情况看, 预计铜抛光液的市场需求将持续增加, 不存在市场需求瓶颈, 且快速迭代的风险较小。

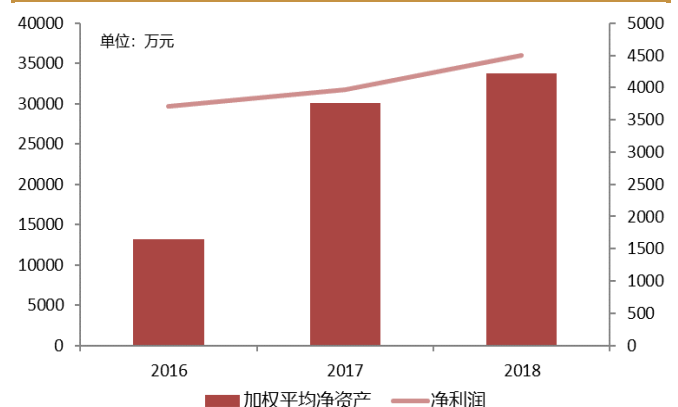
2018 年度公司加权平均净资产收益率为 13.3%, 较 2017 年基本保持不变。每股收益 1.08 元, 较 2017 年增长 16.13%。相比 2016 年公司 ROE 下降的主要原因是发行募集资金到位后, 公司净资产和股本总额较发行前有所增加, 而公司投资研发的产品存在门槛高、周期长等特点, 募集资金拟投资项目的实施和达产需要一定时间, 导致资产收益率下降。本次募集资金同样存在 ROE 短期内下降的可能。

图 9: 2016-2018 年公司 ROE 与每股收益



数据来源: 公司公告, 西南证券整理

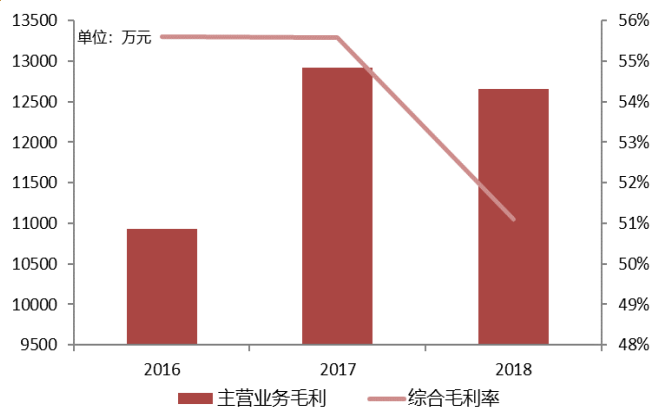
图 10: 2016-2018 年公司净资产和净利润走势



数据来源: Wind, 西南证券整理

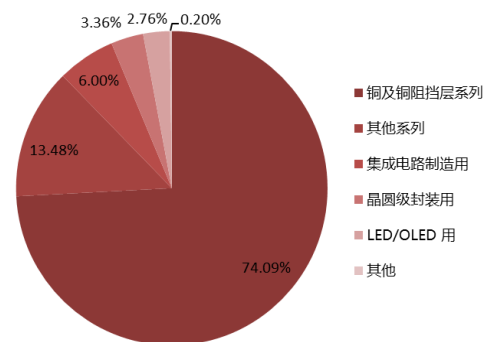
2018 年公司综合毛利率为 51.1%，比 2017 年略有下降，基本维持在较高水平。公司较高的毛利率主要依靠一系列具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰、技术水平国际先进或国内领先，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。2018 年毛利率下降 4.5 个百分点，主要原因是收入结构发生变化，毛利率相对较高的铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液的收入占比从 75.0%下降至 66.3%，同时公司对已稳定销售多年的产品选择性降价来维持产品竞争优势，导致该系列产品毛利率下降 2.8 个百分点。

图 11：2016-2018 年公司毛利率



数据来源：公司公告，西南证券整理

图 12：2018 年公司产品毛利构成

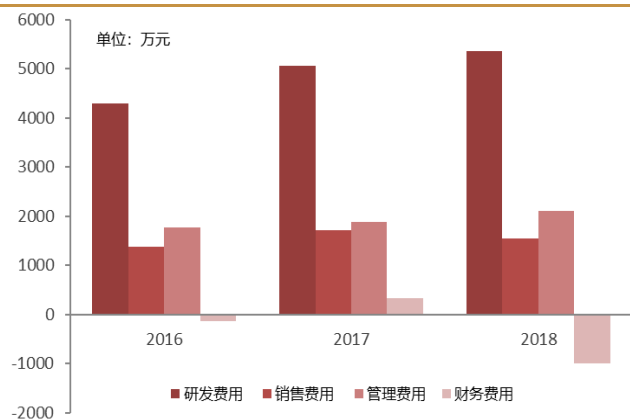


数据来源：公司公告，西南证券整理

2.2 研发持续高投入，未来发展可期

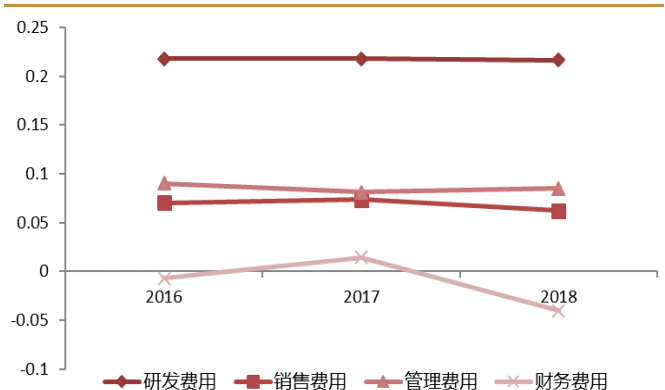
2016 年、2017 年和 2018 年，公司期间费用合计分别为 7301.4 万元、8983.0 万元和 8015.1 万元，占营业收入的比重分别为 37.1%、38.7%和 32.3%。公司销售费用、管理费用、研发费用占营业收入的比例基本稳定，财务费用占比随美元兑人民币汇率波动有所影响。研发费用高的原因是因为公司作为科技创新企业，持续大量的研发投入是公司产品能与制程不断推进的集成电路制造及先进封装技术同步的关键，包括投资铜抛光液系列等已有产品的研发和阻挡层抛光液系列、钨化学机械抛光液等新产品的研发。

图 13：2016-2018 年公司各项费用



数据来源：公司公告，西南证券整理

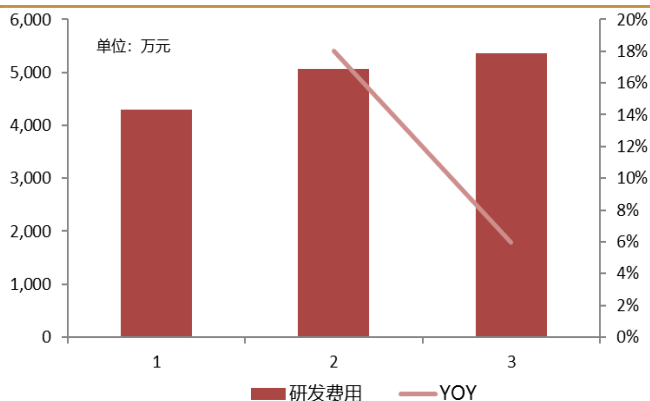
图 14：2018 年公司费用收入占比



数据来源：公司公告，西南证券整理

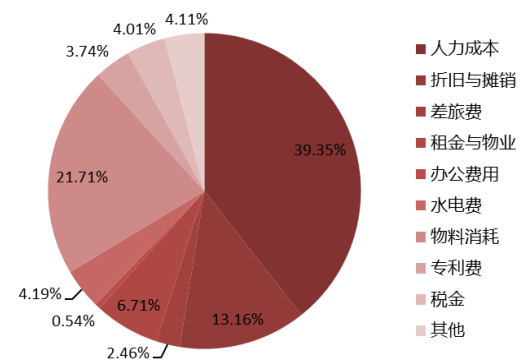
公司研发费用占营业收入比重较高, 2018 年公司研发费用为 5363.15 万元, 占营业收入的比例为 21.6%。研发费用主要由人力成本、物料消耗、折旧与摊销费用等构成, 其中人力成本是公司研发费用最主要的组成部分, 有效保证了公司研发能力的提升。2017 年和 2018 年研发费用分别较上年增长 18.0% 和 6.0%, 主要原因系人力成本、物料耗用和专利费的增长, 这与公司业务开拓和发展过程中不断开展研发活动和提升研发能力相匹配。

图 15: 2016-2018 年公司研发费用及增长率



数据来源: 公司公告, 西南证券整理

图 16: 2016-2018 年公司研发费用构成



数据来源: 公司公告, 西南证券整理

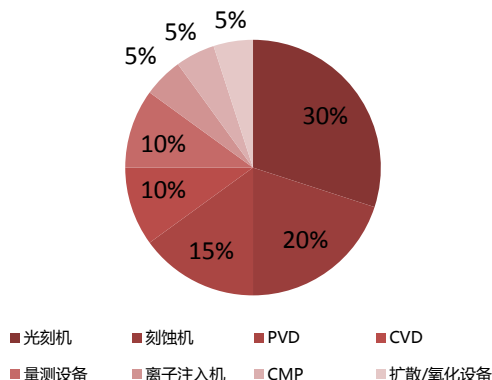
3 国产替代正当时, CMP 需求将维持高增长

材料和设备是半导体产业的基石, 是推动集成电路创新的引擎。一代技术依赖于一代工艺, 一代工艺依赖一代材料和设备来实现。半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节, 对半导体发展起着重要支撑作用, 具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、更新换代快等特点。

第一个特点是**产业规模大**。根据 SEMI 统计, 2017 年全球半导体销售额为 469.3 亿美元, 中国大陆销售额 76.2 亿美元, 占比 16%。第二是**细分行业多**, 半导体材料行业是半导体细分产领域中最多的产业链环节, 晶圆制造材料包括硅片、SOI、掩膜版、光刻胶、电子气体、工艺化学品、靶材、CMP 材料以及其他材料, 封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包装材料、芯片粘接材料以及其他材料。每一大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品, 细分子行业多达上百个。第三是**技术门槛高**, 半导体材料技术门槛一般高于其他电子制造领域相关材料, 在研发过程中需要下游对应产线进行批量测试。同时, 芯片制造过程的不同和下游厂商对于材料的要求也不同。

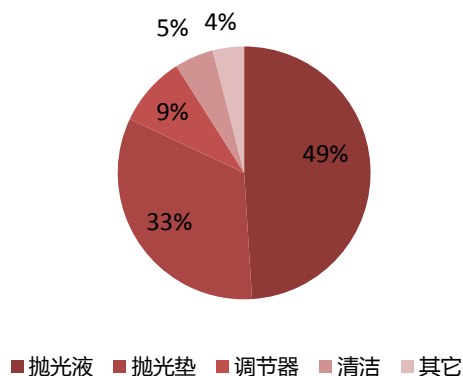
CMP 材料包括抛光液、抛光垫、调节器、清洁材料等, 抛光液和抛光垫是核心材料, 其中抛光液占比 49%, 抛光垫占比 33%。抛光液一般由研磨材料如纳米二氧化硅, 氧化铝等粒子和化学添加剂如表面活性剂、稳定剂、氧化剂等组成。

图 17: 晶圆制造材料投资占比



数据来源: Global Foundries, 西南证券整理

图 18: CMP 各细分材料份额占比

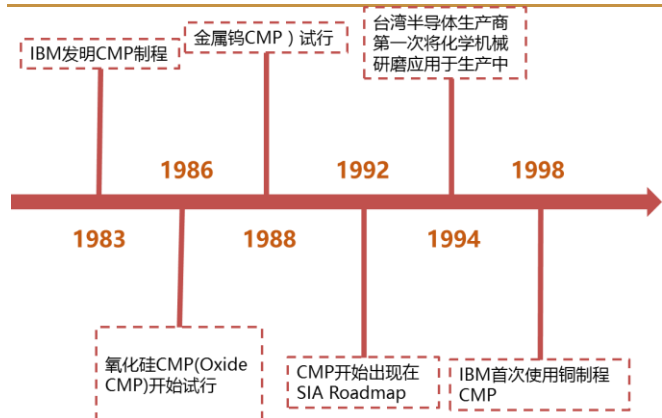


数据来源: 产业信息网, 西南证券整理

化学机械抛光 (CMP) 是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。与传统的机械或纯化学的抛光方法不同, CMP 工艺是通过表面化学和机械研磨的技术结合来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去除, 从而达到晶圆表面的高度 (纳米级) 平坦化效应, 使下一步的光刻得以进行。

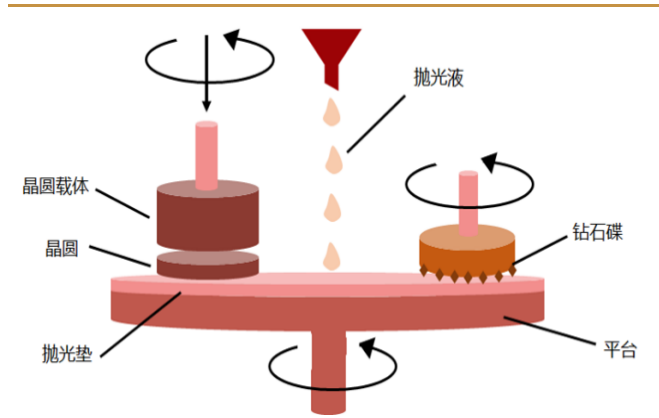
CMP 的主要工作原理是在一定压力下及抛光液的存在下, 被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动, 借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合, 使被抛光的晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。根据不同工艺制程和技术节点的要求, 每一片晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的 CMP 抛光工艺步骤。

图 19: CMP 发展历程



数据来源: SMIC, 西南证券整理

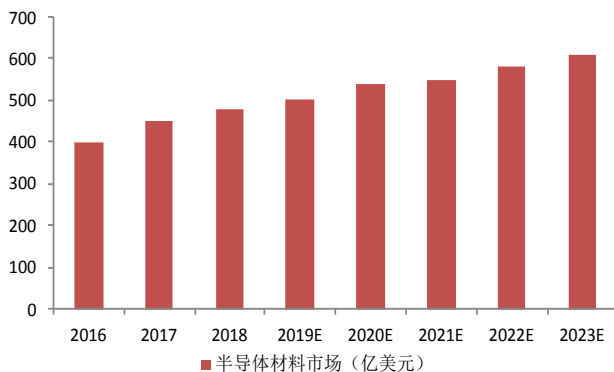
图 20: CMP 工艺原理图



数据来源: 招股说明书, 西南证券整理

半导体材料行业细分领域众多, 不同的子行业在技术上存在较大差异, 半导体材料行业各个子行业的行业龙头各不相同。从半导体材料行业竞争格局看, 全球半导体材料产业依然由美国、日本等厂商占据绝对主导, 国内半导体材料企业和海外材料龙头仍存在较大差距。

图 21: 全球半导体材料市场空间

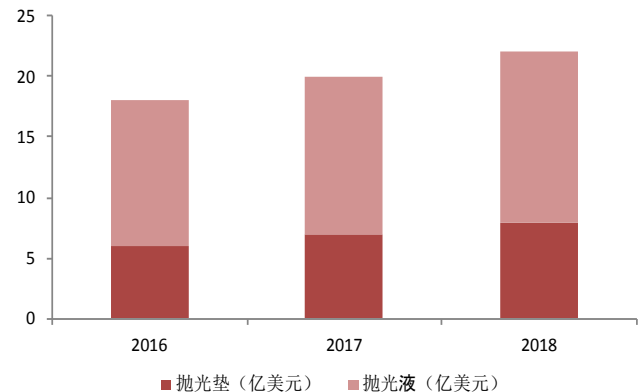


数据来源: Techcet, 西南证券整理

根据 Techcet 统计数据显示, 2019 年半导体材料市场将达到 500 亿美元之上, 增长超过 3%。由于各种半导体芯片的需求稳步增长, 使 2018 年的材料市场总收入达到 489 亿美元, 而预计到 2023 年的复合年增长率 (CAGR) 预计为 4.3%。

根据 Cabot Microelectronics 官网公开披露的资料, 2018 年全球 CMP 抛光材料市场规模为 20.1 亿美元, 其中抛光液和抛光垫市场规模分别为 12.7 亿美元和 7.4 亿美元, 预计 2017-2020 年全球 CMP 抛光材料市场规模年复合增长率为 6%。

图 22: 全球 CMP 材料市场空间

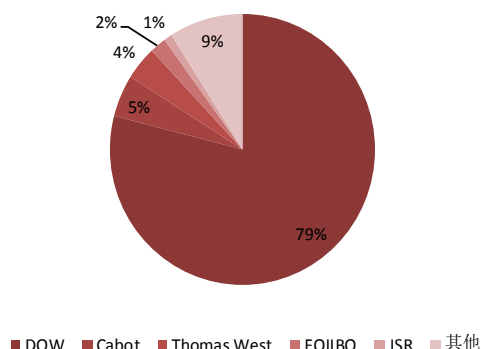


数据来源: 招股说明书, 西南证券整理

4 美日厂商垄断 CMP 市场, 奋起直追正当时

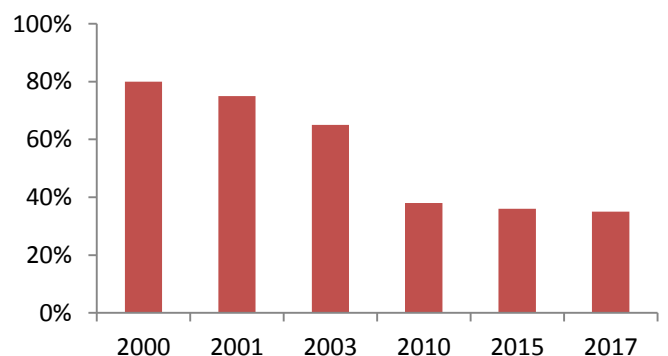
CMP 市场呈现寡头垄断的局面。由于科技含量极高, CMP 抛光材料研发所需的资金投入较大, 一些较小的供应商, 无法承受巨大的研发投入。与此同时美国和日本等国际巨头利用先发优势在研发和生产方面不断革新, 同时实行严格的专利保护封锁技术防止外泄, 构筑难以突破的技术壁垒。不同于传统行业, 半导体的发展路径由摩尔定律决定, 平均来说半导体芯片每 18 个月性能就要翻倍一次, 由此所需要的原材料的更新换代频率也极快。

图 23: 全球 CMP 抛光垫市场竞争格局



数据来源: Techcet, 西南证券整理

图 24: Cabot Microelectronics 全球抛光液市场份额变化



数据来源: 招股说明书, 西南证券整理

在抛光液市场，Cabot Microelectronics 全球抛光液市场占有率最高，但是市占率已经从 2000 年的 80% 下降至 2017 年的 35%，表明未来全球抛光液市场朝向多元化发展，本土化自给率将得到提升。在抛光垫市场，全球 CMP 抛光垫几乎全部被陶氏所垄断，陶氏公司占据全球抛光垫市场 79% 的市场份额。此外，3M、卡博特、日本东丽、台湾三方化学等可生产部分抛光垫。

表 1：公司抛光液产品主要竞争对手

竞争对手	所属国家	公司简介
Cabot Microelectronics	美国	全球领先的化学机械抛光液供应商和第二大化学机械抛光垫供应商。
Versum	美国	Versum 拥有材料、交付系统和服务两大业务，其中材料业务又包括先进材料和工艺材料两大产品类别。
Fujimi	日本	Fujimi 是合成精密研磨剂制造商，产品线包括硅晶圆及其他半导体衬底的抛光研磨剂、半导体芯片上多层电路所需的化学机械抛光产品、电脑硬盘研磨剂，并正在培育金属陶瓷、热喷涂材料等新领域。

数据来源：招股说明书，西南证券整理

5 风险提示

客户集中度较高、产品结构单一的风险；原材料供应及价格上涨风险；产品研发或不及预期；半导体行业景气度下行风险。

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，报告所采用的数据均来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。

投资评级说明

公司评级

买入：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 20%以上
增持：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 10%与 20%之间
中性：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-10%与 10%之间
回避：未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在-10%以下

行业评级

强于大市：未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上
跟随大市：未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间
弱于大市：未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数-5%以下

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告仅供本公司客户中的专业投资者使用，若您并非本公司客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

本报告及附录版权为西南证券所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“西南证券”，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

西南证券研究发展中心

上海

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 20 楼

邮编：200120

北京

地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1501-1502

邮编：100045

重庆

地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 3 楼

邮编：400023

深圳

地址：深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼

邮编：518040

西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	座机	手机	邮箱
上海	蒋诗烽	地区销售总监	021-68415309	18621310081	jsf@swsc.com.cn
	黄丽娟	地区销售副总监	021-68411030	15900516330	hlj@swsc.com.cn
	张方毅	高级销售经理	021-68413959	15821376156	zfyi@swsc.com.cn
	王慧芳	高级销售经理	021-68415861	17321300873	whf@swsc.com.cn
	涂诗佳	销售经理	021-68415296	18221919508	tsj@swsc.com.cn
	杨博睿	销售经理	021-68415861	13166156063	ybz@swsc.com.cn
	丁可莎	销售经理	021-68416017	13122661803	dks@swsc.com.cn
北京	张岚	高级销售经理	18601241803	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn
	路剑	高级销售经理	010-57758566	18500869149	lujian@swsc.com.cn
	刘致莹	销售经理	010-57758619	17710335169	liuzy@swsc.com.cn
广深	王湘杰	销售经理	0755-26671517	13480920685	wxj@swsc.com.cn
	余燕伶	销售经理	0755-26820395	13510223581	yyi@swsc.com.cn
	花洁	销售经理	0755-26673231	18620838809	huaj@swsc.com.cn
	孙瑶瑶	销售经理	0755-26833581	13480870918	sunyaoyao@swsc.com.cn
	陈霄（广州）	销售经理	15521010968	15521010968	chenxiao@swsc.com.cn